

第一节 重要提示

1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

- 2.重大风险提示
- 公司已在本报告中详细描述可能面临的风险及应对措施,有关内容详见年度报告第三节“管理层讨论与分析”,敬请投资者注意阅读。
- 3.本年度报告中,公司董事会、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别及连带的法律责任。
- 4.公司全体董事出席董事会会议。
- 5.会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 6.公司上市时未盈利且尚未实现盈利
- 口是√否
- 7.董事会会议通过的公司报告期内利润分配预案和现金分红预案
- 1.根据成都国光电气股份有限公司(以下简称“公司”)聘请的审计机构中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年度财务报告出具的审计报告:截至2024年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币69,079,347.21元,其中2024年度利润分配后期末可供分配利润为47,061,002.86元。公司按照《上市公司章程指引》第3号《上市公司分红管理办法》等相关规定,并结合行业发展现状、公司发展阶段、公司实际经营情况等各方面因素综合考虑,为更好地维护全体股东的长远权益,保障公司的可持续发展及资金需求,公司2024年度拟不进行现金分红及股票回购。
- 2.公司于2024年10月30日召开第八届董事会第十五次会议与第八届监事会第十四次会议,审议通过了《关于2024年第三季度利润分配预案的议案》,公司向全体股东每10股派发现金红利1.05元(含税),合计派发现金红利10,500,000.00元(含税),占2024年度末经审计归属于上市公司股东的净利润比例为46.26%。
- 综上所述,公司2024年度合计派息总额为人民币20,050,032.52元,能2024年前三季度以现金发放现金红利方式进行利润分配,公司2024年度不派发现金红利,不进行公积金转增股本,不送红股和其他形式的利润分配。
- 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
- 8.是否对会计师事务所的审计意见提出异议
- 口适用√不适用

第二节 基本情况

1.公司简介

1.1公司股票简称

√适用 □不适用

公司股票简称				
股票种类	股票上市交易所及 板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股(A股)	上交所科创板	国光电气	688776	不适用

1.2公司存托凭证情况

□适用 √不适用

1.3联系人和联系方式

- 2.报告期内公司主要业务简介
- 2.1.主要业务
- 公司主要从事微波器件的研发、生产和销售,产品广泛应用于通信、雷达、航空航天等领域。公司是国内微波器件领域的领先企业,拥有自主知识产权,产品性能优异,市场占有率较高。
- 2.2.主要客户
- 公司主要客户包括国内外的知名通信设备制造商、军工企业、科研院所等。公司凭借卓越的产品质量和优质的服务,赢得了客户的广泛认可和信赖。
- 2.3.主要供应商
- 公司主要供应商包括国内外知名的电子元器件制造商、原材料供应商等。公司建立了严格的供应商管理体系,确保原材料的质量和供应的稳定性。

3.主要风险及应对措施

3.1.技术风险

微波器件行业技术更新换代快,公司面临技术落后、研发失败等风险。公司将加大研发投入,加强与科研院所的合作,保持技术领先地位。

3.2.市场风险

微波器件行业竞争激烈,公司面临市场份额下降、价格下降等风险。公司将优化产品结构,提高产品质量,增强市场竞争力。

3.3.财务风险

公司面临资金链紧张、应收账款回收困难等风险。公司将加强资金管理,优化应收账款管理,确保资金链的安全。

4.公司治理与内部控制

4.1.公司治理

公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求,建立健全公司治理体系,规范公司运作。

4.2.内部控制

公司建立了完善的内部控制体系,涵盖了财务管理、人力资源管理、生产管理等方面,确保公司运营的规范性和有效性。

5.未来展望

公司将继续加大研发投入,提升自主创新能力,拓展海外市场,实现高质量发展。公司将秉持“诚信、创新、共赢”的经营理念,为股东创造持续稳定的回报。

6.其他重要事项

6.1.关联交易

报告期内,公司不存在重大关联交易。

6.2.对外担保

报告期内,公司不存在对外担保。

6.3.诉讼仲裁

报告期内,公司不存在重大诉讼仲裁。

7.其他重要事项

7.1.股权激励

报告期内,公司不存在股权激励计划。

7.2.回购股份

报告期内,公司不存在回购股份。

7.3.其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

8.其他重要事项

8.1.社会责任

公司积极履行社会责任,关注员工权益,参与社会公益事业。

8.2.其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

9.其他重要事项

9.1.其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

10.其他重要事项

10.1.其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

11.其他重要事项

11.1.其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

12.其他重要事项

12.1.其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

13.其他重要事项

13.1.其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

14.其他重要事项

14.1.其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

15.其他重要事项

15.1.其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

16.其他重要事项

16.1.其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

17.其他重要事项

17.1.其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

18.其他重要事项

18.1.其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

19.其他重要事项

19.1.其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

20.其他重要事项

20.1.其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

21.其他重要事项

21.1.其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

22.其他重要事项

22.1.其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

23.其他重要事项

23.1.其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

24.其他重要事项

24.1.其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

25.其他重要事项

25.1.其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

26.其他重要事项

26.1.其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

27.其他重要事项

27.1.其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

28.其他重要事项

28.1.其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

29.其他重要事项

29.1.其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

30.其他重要事项

30.1.其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

31.其他重要事项

31.1.其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

32.其他重要事项

32.1.其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

33.其他重要事项

33.1.其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

34.其他重要事项

34.1.其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

35.其他重要事项

35.1.其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

36.其他重要事项

36.1.其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

37.其他重要事项

37.1.其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

38.其他重要事项

38.1.其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

39.其他重要事项

39.1.其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

40.其他重要事项

40.1.其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

41.其他重要事项

41.1.其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

42.其他重要事项

42.1.其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

43.其他重要事项

43.1.其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

44.其他重要事项

44.1.其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

45.其他重要事项

45.1.其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

46.其他重要事项

46.1.其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

47.其他重要事项

47.1.其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

48.其他重要事项

48.1.其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

成都国光电气股份有限公司

2024 年度报告摘要

出全金属膜封装,为后续组件工程奠定坚实基础。公司生产的全金属膜空腔谐振器,其主传输系统采用机械力驱动,整体采用金属封装及有机密封材料,具备优异的耐辐射性能。目前已进入大批量的定制阶段。

(3) 军工领域专用阀门

阀门是军工领域不可缺少的流体控制设备。公司生产的军工领域专用阀门是金属密封阀门,通过顶部传感器接口以及气路快速接口配合使用来控制阀门的启闭,从而控制武器系统中的流体流动。该阀门在军工领域具有广泛的应用,且其密封性能优异,能够满足军工领域对阀门的高要求。目前,公司已成功研发出多款军工领域专用阀门,并已进入批量生产阶段。

(4) 军工领域专用风机

公司研制的风机主要应用在军工领域特殊气体制备系统中,具有耐辐射强、耐温高等特点。主要应用于特殊气体(如氙气、氪气)的制备系统中,作为核心部件,确保制备过程的稳定性和安全性。该风机采用特殊材料制造,能够有效抵抗辐射和高温,同时具备良好的密封性能,防止气体泄漏。目前,公司已成功研发出多款军工领域专用风机,并已进入批量生产阶段。

(5) 特殊气体回收系统

特殊气体回收系统是军工领域全金属膜封装阀门成功应用,以及风机、管路连接、安全技术保障,为公司研制了全金属膜封装阀门的成功应用。该回收系统主要用于回收和处理在特殊气体制备过程中产生的废气,确保制备过程的安全性和环保性。系统采用先进的回收技术和材料,能够有效回收和处理各种特殊气体,防止其对环境造成污染。目前,公司已成功研发出多款特殊气体回收系统,并已进入批量生产阶段。

(6) 微波器件封装技术

微波器件封装技术是微波器件生产的关键技术,包括封装材料选择、封装结构设计、封装工艺控制等。公司通过自主研发,掌握了先进的微波器件封装技术,能够有效提高微波器件的可靠性和性能。目前,公司已成功研发出多款微波器件封装技术,并已进入批量生产阶段。

(7) 微波器件封装技术

微波器件封装技术是微波器件生产的关键技术,包括封装材料选择、封装结构设计、封装工艺控制等。公司通过自主研发,掌握了先进的微波器件封装技术,能够有效提高微波器件的可靠性和性能。目前,公司已成功研发出多款微波器件封装技术,并已进入批量生产阶段。

(8) 微波器件封装技术

微波器件封装技术是微波器件生产的关键技术,包括封装材料选择、封装结构设计、封装工艺控制等。公司通过自主研发,掌握了先进的微波器件封装技术,能够有效提高微波器件的可靠性和性能。目前,公司已成功研发出多款微波器件封装技术,并已进入批量生产阶段。

(9) 微波器件封装技术

微波器件封装技术是微波器件生产的关键技术,包括封装材料选择、封装结构设计、封装工艺控制等。公司通过自主研发,掌握了先进的微波器件封装技术,能够有效提高微波器件的可靠性和性能。目前,公司已成功研发出多款微波器件封装技术,并已进入批量生产阶段。

(10) 微波器件封装技术

微波器件封装技术是微波器件生产的关键技术,包括封装材料选择、封装结构设计、封装工艺控制等。公司通过自主研发,掌握了先进的微波器件封装技术,能够有效提高微波器件的可靠性和性能。目前,公司已成功研发出多款微波器件封装技术,并已进入批量生产阶段。

(11) 微波器件封装技术

微波器件封装技术是微波器件生产的关键技术,包括封装材料选择、封装结构设计、封装工艺控制等。公司通过自主研发,掌握了先进的微波器件封装技术,能够有效提高微波器件的可靠性和性能。目前,公司已成功研发出多款微波器件封装技术,并已进入批量生产阶段。

(12) 微波器件封装技术

微波器件封装技术是微波器件生产的关键技术,包括封装材料选择、封装结构设计、封装工艺控制等。公司通过自主研发,掌握了先进的微波器件封装技术,能够有效提高微波器件的可靠性和性能。目前,公司已成功研发出多款微波器件封装技术,并已进入批量生产阶段。

(13) 微波器件封装技术

微波器件封装技术是微波器件生产的关键技术,包括封装材料选择、封装结构设计、封装工艺控制等。公司通过自主研发,掌握了先进的微波器件封装技术,能够有效提高微波器件的可靠性和性能。目前,公司已成功研发出多款微波器件封装技术,并已进入批量生产阶段。

(14) 微波器件封装技术

微波器件封装技术是微波器件生产的关键技术,包括封装材料选择、封装结构设计、封装工艺控制等。公司通过自主研发,掌握了先进的微波器件封装技术,能够有效提高微波器件的可靠性和性能。目前,公司已成功研发出多款微波器件封装技术,并已进入批量生产阶段。

(15) 微波器件封装技术

微波器件封装技术是微波器件生产的关键技术,包括封装材料选择、封装结构设计、封装工艺控制等。公司通过自主研发,掌握了先进的微波器件封装技术,能够有效提高微波器件的可靠性和性能。目前,公司已成功研发出多款微波器件封装技术,并已进入批量生产阶段。

(16) 微波器件封装技术

微波器件封装技术是微波器件生产的关键技术,包括封装材料选择、封装结构设计、封装工艺控制等。公司通过自主研发,掌握了先进的微波器件封装技术,能够有效提高微波器件的可靠性和性能。目前,公司已成功研发出多款微波器件封装技术,并已进入批量生产阶段。

(17) 微波器件封装技术

微波器件封装技术是微波器件生产的关键技术,包括封装材料选择、封装结构设计、封装工艺控制等。公司通过自主研发,掌握了先进的微波器件封装技术,能够有效提高微波器件的可靠性和性能。目前,公司已成功研发出多款微波器件封装技术,并已进入批量生产阶段。

(18) 微波器件封装技术

微波器件封装技术是微波器件生产的关键技术,包括封装材料选择、封装结构设计、封装工艺控制等。公司通过自主研发,掌握了先进的微波器件封装技术,能够有效提高微波器件的可靠性和性能。目前,公司已成功研发出多款微波器件封装技术,并已进入批量生产阶段。

(19) 微波器件封装技术

微波器件封装技术是微波器件生产的关键技术,包括封装材料选择、封装结构设计、封装工艺控制等。公司通过自主研发,掌握了先进的微波器件封装技术,能够有效提高微波器件的可靠性和性能。目前,公司已成功研发出多款微波器件封装技术,并已进入批量生产阶段。

(20) 微波器件封装技术

微波器件封装技术是微波器件生产的关键技术,包括封装材料选择、封装结构设计、封装工艺控制等。公司通过自主研发,掌握了先进的微波器件封装技术,能够有效提高微波器件的可靠性和性能。目前,公司已成功研发出多款微波器件封装技术,并已进入批量生产阶段。

(21) 微波器件封装技术

微波器件封装技术是微波器件生产的关键技术,包括封装材料选择、封装结构设计、封装工艺控制等。公司通过自主研发,掌握了先进的微波器件封装技术,能够有效提高微波器件的可靠性和性能。目前,公司已成功研发出多款微波器件封装技术,并已进入批量生产阶段。

(22) 微波器件封装技术

微波器件封装技术是微波器件生产的关键技术,包括封装材料选择、封装结构设计、封装工艺控制等。公司通过自主研发,掌握了先进的微波器件封装技术,能够有效提高微波器件的可靠性和性能。目前,公司已成功研发出多款微波器件封装技术,并已进入批量生产阶段。

(23) 微波器件封装技术

微波器件封装技术是微波器件生产的关键技术,包括封装材料选择、封装结构设计、封装工艺控制等。公司通过自主研发,掌握了先进的微波器件封装技术,能够有效提高微波器件的可靠性和性能。目前,公司已成功研发出多款微波器件封装技术,并已进入批量生产阶段。

(24) 微波器件封装技术

微波器件封装技术是微波器件生产的关键技术,包括封装材料选择、封装结构设计、封装工艺控制等。公司通过自主研发,掌握了先进的微波器件封装技术,能够有效提高微波器件的可靠性和性能。目前,公司已成功研发出多款微波器件封装技术,并已进入批量生产阶段。

(25) 微波器件封装技术

微波器件封装技术是微波器件生产的关键技术,包括封装材料选择、封装结构设计、封装工艺控制等。公司通过自主研发,掌握了先进的微波器件封装技术,能够有效提高微波器件的可靠性和性能。目前,公司已成功研发出多款微波器件封装技术,并已进入批量生产阶段。

(26) 微波器件封装技术

微波器件封装技术是微波器件生产的关键技术,包括封装材料选择、封装结构设计、封装工艺控制等。公司通过自主研发,掌握了先进的微波器件封装技术,能够有效提高微波器件的可靠性和性能。目前,公司已成功研发出多款微波器件封装技术,并已进入批量生产阶段。

(27) 微波器件封装技术

微波器件封装技术是微波器件生产的关键技术,包括封装材料选择、封装结构设计、封装工艺控制等。公司通过自主研发,掌握了先进的微波器件封装技术,能够有效提高微波器件的可靠性和性能。目前,公司已成功研发出多款微波器件封装技术,并已进入批量生产阶段。

(28) 微波器件封装技术

微波器件封装技术是微波器件生产的关键技术,包括封装材料选择、封装结构设计、封装工艺控制等。公司通过自主研发,掌握了先进的微波器件封装技术,能够有效提高微波器件的可靠性和性能。目前,公司已成功研发出多款微波器件封装技术,并已进入批量生产阶段。

(29) 微波器件封装技术

微波器件封装技术是微波器件生产的关键技术,包括封装材料选择、封装结构设计、封装工艺控制等。公司通过自主研发,掌握了先进的微波器件封装技术,能够有效提高微波器件的可靠性和性能。目前,公司已成功研发出多款微波器件封装技术,并已进入批量生产阶段。

(30) 微波器件封装技术

微波器件封装技术是微波器件生产的关键技术,包括封装材料选择、封装结构设计、封装工艺控制等。公司通过自主研发,掌握了先进的微波器件封装技术,能够有效提高微波器件的可靠性和性能。目前,公司已成功研发出多款微波器件封装技术,并已进入批量生产阶段。

(31) 微波器件封装技术

微波器件封装技术是微波器件生产的关键技术,包括封装材料选择、封装结构设计、封装工艺控制等。公司通过自主研发,掌握了先进的微波器件封装技术,能够有效提高微波器件的可靠性和性能。目前,公司已成功研发出多款微波器件封装技术,并已进入批量生产阶段。

(32) 微波器件封装技术

微波器件封装技术是微波器件生产的关键技术,包括封装材料选择、封装结构设计、封装工艺控制等。公司通过自主研发,掌握了先进的微波器件封装技术,能够有效提高微波器件的可靠性和性能。目前,公司已成功研发出多款微波器件封装技术,并已进入批量生产阶段。

(33) 微波器件封装技术

微波器件封装技术是微波器件生产的关键技术,包括封装材料选择、封装结构设计、封装工艺控制等。公司通过自主研发,掌握了先进的微波器件封装技术,能够有效提高微波器件的可靠性和性能。目前,公司已成功研发出多款微波器件封装技术,并已进入批量生产阶段。

(34) 微波器件封装技术

微波器件封装技术是微波器件生产的关键技术,包括封装材料选择、封装结构设计、封装工艺控制等。公司通过自主研发,掌握了先进的微波器件封装技术,能够有效提高微波器件的可靠性和性能。目前,公司已成功研发出多款微波器件封装技术,并已进入批量生产阶段。

(35) 微波器件封装技术

微波器件封装技术是微波器件生产的关键技术,包括封装材料选择、封装结构设计、封装工艺控制等。公司通过自主研发,掌握了先进的微波器件封装技术,能够有效提高微波器件的可靠性和性能。目前,公司已成功研发出多款微波器件封装技术,并已进入批量生产阶段。

(36) 微波器件封装技术

微波器件封装技术是微波器件生产的关键技术,包括封装材料选择、封装结构设计、封装工艺控制等。公司通过自主研发,掌握了先进的微波器件封装技术,能够有效提高微波器件的可靠性和性能。目前,公司已成功研发出多款微波器件封装技术,并已进入批量生产阶段。

(37) 微波器件封装技术

微波器件封装技术是微波器件生产的关键技术,包括封装材料选择、封装结构设计、封装工艺控制等。公司通过自主研发,掌握了先进的微波器件封装技术,能够有效提高微波器件的可靠性和性能。目前,公司已成功研发出多款微波器件封装技术,并已进入批量生产阶段。

(38) 微波器件封装技术

微波器件封装技术是微波器件生产的关键技术,包括封装材料选择、封装结构设计、封装工艺控制等。公司通过自主研发,掌握了先进的微波器件封装技术,能够有效提高微波器件的可靠性和性能。目前,公司已成功研发出多款微波器件封装技术,并已进入批量生产阶段。

(39) 微波器件封装技术

微波器件封装技术是微波器件生产的关键技术,包括封装材料选择、封装结构设计、封装工艺控制等。公司通过自主研发,掌握了先进的微波器件封装技术,能够有效提高微波器件的可靠性和性能。目前,公司已成功研发出多款微波器件封装技术,并已进入批量生产阶段。

(40) 微波器件封装技术

微波器件封装技术是微波器件生产的关键技术,包括封装材料选择、封装结构设计、封装工艺控制等。公司通过自主研发,掌握了先进的微波器件封装技术,能够有效提高微波器件的可靠性和性能。目前,公司已成功研发出多款微波器件封装技术,并已进入批量生产阶段。

(41) 微波器件封装技术

微波器件封装技术是微波器件生产的关键技术,包括封装材料选择、封装结构设计、封装工艺控制等。公司通过自主研发,掌握了先进的微波器件封装技术,能够有效提高微波器件的可靠性和性能。目前,公司已成功研发出多款微波器件封装技术,并已进入批量生产阶段。

(42) 微波器件封装技术

微波器件封装技术是微波器件生产的关键技术,包括封装材料选择、封装结构设计、封装工艺控制等。公司通过自主研发,掌握了先进的微波器件封装技术,能够有效提高微波器件的可靠性和性能。目前,公司已成功研发出多款微波器件封装技术,并已进入批量生产阶段。

(43) 微波器件封装技术

微波器件封装技术是微波器件生产的关键技术,包括封装材料选择、封装结构设计、封装工艺控制等。公司通过自主研发,掌握了先进的微波器件封装技术,能够有效提高微波器件的可靠性和性能。目前,公司已成功研发出多款微波器件封装技术,并已进入批量生产阶段。

(44) 微波器件封装技术

微波器件封装技术是微波器件生产的关键技术,包括封装材料选择、封装结构设计、封装工艺控制等。公司通过自主研发,掌握了先进的微波器件封装技术,能够有效提高微波器件的可靠性和性能。目前,公司已成功研发出多款微波器件封装技术,并已进入批量生产阶段。

(45) 微波器件封装技术

微波器件封装技术是微波器件生产的关键技术,包括封装材料选择、封装结构设计、封装工艺控制等。公司通过自主研发,掌握了先进的微波器件封装技术,能够有效提高微波器件的可靠性和性能。目前,公司已成功研发出多款微波器件封装技术,并已进入批量生产阶段。

(46) 微波器件封装技术

微波器件封装技术是微波器件生产的关键技术,包括封装材料选择、封装结构设计、封装工艺控制等。公司通过自主研发,掌握了先进的微波器件封装技术,能够有效提高微波器件的可靠性和性能。目前,公司已成功研发出多款微波器件封装技术,并已进入批量生产阶段。

(47) 微波器件封装技术

微波器件封装技术是微波器件生产的关键技术,包括封装材料选择、封装结构设计、封装工艺控制等。公司通过自主研发,掌握了先进的微波器件封装技术,能够有效提高微波器件的可靠性和性能。目前,公司已成功研发出多款微波器件封装技术,并已进入批量生产阶段。

(48) 微波器件封装技术

微波器件封装技术是微波器件生产的关键技术,包括封装材料选择、封装结构设计、封装工艺控制等。公司通过自主研发,掌握了先进的微波器件封装技术,能够有效提高微波器件的可靠性和性能。目前,公司已成功研发出多款微波器件封装技术,并已进入批量生产阶段。

(49) 微波器件封装技术

微波器件封装技术是微波器件生产的关键技术,包括封装材料选择、封装结构设计、封装工艺控制等。公司通过自主研发,掌握了先进的微波器件封装技术,能够有效提高微波器件的可靠性和性能。目前,公司已成功研发出多款微波器件封装技术,并已进入批量生产阶段。

(50) 微波器件封装技术

微波器件封装技术是微波器件生产的关键技术,包括封装材料选择、封装结构设计、封装工艺控制等。公司通过自主研发,掌握了先进的微波器件封装技术,能够有效提高微波器件的可靠性和性能。目前,公司已成功研发出多款微波器件封装技术,并已进入批量生产阶段。

(51) 微波器件封装技术

微波器件封装技术是微波器件生产的关键技术,包括封装材料选择、封装结构设计、封装工艺控制等。公司通过自主研发,掌握了先进的微波器件封装技术,能够有效提高微波器件的可靠性和性能。目前,公司已成功研发出多款微波器件封装技术,并已进入批量生产阶段。

(52) 微波器件封装技术

微波器件封装技术是微波器件生产的关键技术,包括封装材料选择、封装结构设计、封装工艺控制等。公司通过自主研发,掌握了先进的微波器件封装技术,能够有效提高微波器件的可靠性和性能。目前,公司已成功研发出多款微波器件封装技术,并已进入批量生产阶段。

(53) 微波器件封装技术

微波器件封装技术是微波器件生产的关键技术,包括封装材料选择、封装结构设计、封装工艺控制等。公司通过自主研发,掌握了先进的微波器件封装技术,能够有效提高微波器件的可靠性和性能。目前,公司已成功研发出多款微波器件封装技术,并已进入批量生产阶段。

(54) 微波器件封装技术

微波器件封装技术是微波器件生产的关键技术,包括封装材料选择、封装结构设计、封装工艺控制等。公司通过自主研发,掌握了先进的微波器件封装技术,能够有效提高微波器件的可靠性和性能。目前,公司已成功研发出多款微波器件封装技术,并已进入批量生产阶段。

(55) 微波器件封装技术

微波器件封装技术是微波器件生产的关键技术,包括封装材料选择、封装结构设计、封装工艺控制等。公司通过自主研发,掌握了先进的微波器件封装技术,能够有效提高微波器件的可靠性和性能。目前,公司已成功研发出多款微波器件封装技术,并已进入批量生产阶段。

(56) 微波器件封装技术

微波器件封装技术是微波器件生产的关键技术,包括封装材料选择、封装结构设计、封装工艺控制等。公司通过自主研发,掌握了先进的微波器件封装技术,能够有效提高微波器件的可靠性和性能。目前,公司已成功研发出多款微波器件封装技术,并已进入批量生产阶段。

(57) 微波器件封装技术

微波器件封装技术是微波器件生产的关键技术,包括封装材料选择、封装结构设计、封装工艺控制等。公司通过自主研发,掌握了先进的微波器件封装技术,能够有效提高微波器件的可靠性和性能。目前,公司已成功研发出多款微波器件封装技术,并已进入批量生产阶段。

出全金属膜封装,为后续组件工程奠定坚实基础。公司生产的全金属膜空腔谐振器,其主传输系统采用机械力驱动,整体采用金属封装及有机密封材料,具备优异的耐辐射性能。目前已进入大批量的定制阶段。

(3) 军工领域专用阀门

阀门是军工领域不可缺少的流体控制设备。公司生产的军工领域专用阀门是金属密封阀门,通过顶部传感器接口以及气路快速接口配合使用来控制阀门的启闭,从而控制武器系统中的流体流动。该阀门在军工领域具有广泛的应用,且其密封性能优异,能够满足军工领域对阀门的高要求。目前,公司已成功研发出多款军工领域专用阀门,并已进入批量生产阶段。

(4) 军工领域专用风机

公司研制的风机主要应用在军工领域特殊气体制备系统中,具有耐辐射强、耐温高等特点。主要应用于特殊气体(如氙气、氪气)的制备系统中,作为核心部件,确保制备过程的稳定性和安全性。该风机采用特殊材料制造,能够有效抵抗辐射和高温,同时具备良好的密封性能,防止气体泄漏。目前,公司已成功研发出多款军工领域专用风机,并已进入批量生产阶段。

(5) 特殊气体回收系统

特殊气体回收系统是军工领域全金属膜封装阀门成功应用,以及风机、管路连接、安全技术保障,为公司研制了全金属膜封装阀门的成功应用。该回收系统主要用于回收和处理在特殊气体制备过程中产生的废气,确保制备过程的安全性和环保性。系统采用先进的回收技术和材料,能够有效回收和处理各种特殊气体,防止其对环境造成污染。目前,公司已成功研发出多款特殊气体回收系统,并已进入批量生产阶段。

(6) 微波器件封装技术

微波器件封装技术是微波器件生产的关键技术,包括封装材料选择、封装结构设计、封装工艺控制等。公司通过自主研发,掌握了先进的微波器件封装技术,能够有效提高微波器件的可靠性和性能。目前,公司已成功研发出多款微波器件封装技术,并已进入批量生产阶段。

(7) 微波器件封装技术

微波器件封装技术是微波器件生产的关键技术,包括封装材料选择、封装结构设计、封装工艺控制等。公司通过自主研发,掌握了先进的微波器件封装技术,能够有效提高微波器件的可靠性和性能。目前,公司已成功研发出多款微波器件封装技术,并已进入批量生产阶段。

(8) 微波器件封装技术

微波器件封装技术是微波器件生产的关键技术,包括封装材料选择、封装结构设计、封装工艺控制等。公司通过自主研发,掌握了先进的微波器件封装技术,能够有效提高微波器件的可靠性和性能。目前,公司已成功研发出多款微波器件封装技术,并已进入批量生产阶段。

(9) 微波器件封装技术

微波器件封装技术是微波器件生产的关键技术,包括封装材料选择、封装结构设计、封装工艺控制等。公司通过自主研发,掌握了先进的微波器件封装技术,能够有效提高微波器件的可靠性和性能。目前,公司已成功研发出多款微波器件封装技术,并已进入批量生产阶段。

(10) 微波器件封装技术

微波器件封装技术是微波器件生产的关键技术,包括封装材料选择、封装结构设计、封装工艺控制等。公司通过自主研发,掌握了先进的微波器件封装技术,能够有效提高微波器件的可靠性和性能。目前,公司已成功研发出多款微波器件封装技术,并已进入批量生产阶段。

(11) 微波器件封装技术

微波器件封装技术是微波器件生产的关键技术,包括封装材料选择、封装结构设计、封装工艺控制等。公司通过自主研发,掌握了先进的微波器件封装技术,能够有效提高微波器件的可靠性和性能。目前,公司已成功研发出多款微波器件封装技术,并已进入批量生产阶段。

(12) 微波器件封装技术

微波器件封装技术是微波器件生产的关键技术,包括封装材料选择、封装结构设计、封装工艺控制等。公司通过自主研发,掌握了先进的微波器件封装技术,能够有效提高微波器件的可靠性和性能。目前,公司已成功研发出多款微波器件封装技术,并已进入批量生产阶段。

(13